

Photonics Systems GmbH
Pionierstrasse 6
82152 Krailling

T_ +49 (89) 8105 9168-0
F_ +49 (89) 8105 9168-1900
E_ sales@ps-group.net

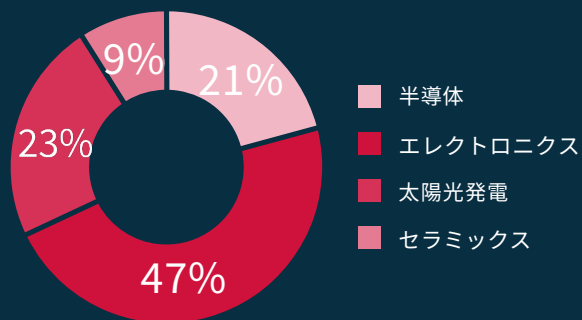


日本正規代理店
ワールドリンク合同会社
大阪府池田市旭丘 1-4-7

T_072-736-9959
F_072-736-9965
E_info@worldlink-jp.com



市場シェア内訳



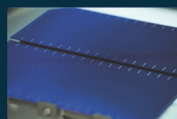
用途分野



センサー / ミックス
ドシグナル



プリント基板



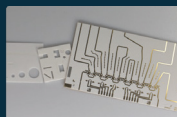
太陽光発電



パワーエレクトロ
ニクス



パッケージング



セラミックス /
ハイブリッド

次世代レーザー デパネリング DP10XX

リジッド・フレックス両対応 PCBA 用 多用
途レーザーデパネリングプラットフォーム



特長

- 最先端レーザー製造装置
- 24 時間 365 日稼働対応
- 導入しやすいトータルハンドリングソリューション
- MES とのカスタム連携
- 自動車業界で認められたレーザープロセス
- リジッド・フレキシブル両方の基板材料に対応
- 資材効率の最適化

注目ポイント

- 応力や切りくずの発生しないレーザー加工
- 炭化なしで高精度・高品質なカット
- 最大パネルサイズ 18x18 インチ
- 幅広いレーザー発振器オプション
- 第 2 加工ヘッド搭載



デュアルヘッド仕様



全自動ハンドリング

PSGは30年以上の豊富な経験を持ち、レーザー微細加工、自動化、検査装置分野において業界をリードするパイオニアです。



世界中で提供されるプロフェッショナルなサポートとサービスにより、常にお客様のそばで24時間365日対応します。



専用製品ラインナップと高品質なプロダクトで、所有コストを最小限に。自動化や検査によるアップグレードも可能です。

デバイス IC フロントエンド



ウェファートリム
WT35XX シリーズ



ウェファーフューズ
WF10XX シリーズ



サーキットトリム
LT50XX シリーズ



カスタマイズ
PIPOCAPIPOCA シリーズ

PCB IC パッケージング



ドリル加工・ルーティング
DR20XX シリーズ



ドリル加工・ルーティング
DR30XX シリーズ
大型基板対応

セラミックス



切断・穴あけ加工
CR20XX シリーズ

SMT 組立



基板分割
DP10XX シリーズ

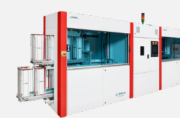
太陽光発電



コンタクト開口 ULTAGO
プラットフォーム







レーザーエッジ削除
DIMENSO プラットフォーム



セルカット (LDC)
Lumion プラットフォーム

STANDARD SPECIFICATIONS

	DP1010	DP1020	DP1030	DP1040
				
Laser Type	– green Nanosecond	– green Nanosecond	– green Nanosecond	– green Nanosecond
Wavelength	– 532 nm	– 532 nm	– 532 nm	– 532 nm
Average Laser Power	– up to 48 W	– up to 48 W	– up to 48 W	– up to 48 W
Laser Power Measurement	– Integrated Automatic	– Integrated Automatic	– Integrated Automatic	– Integrated Automatic
Max. Panel Size Single Head	– 460 mm x 500 mm	– 305 mm x 460 mm	– 305 mm x 460 mm	– 305 mm x 460 mm
Max. Panel Size Dual Head	– 2x (230 mm x 305 mm)	– 2x (230 mm x 305 mm)	– 2x (230 mm x 305 mm)	– 2x (230 mm x 305 mm)
Accuracy	– $< \pm 25 \mu\text{m}$	– $< \pm 25 \mu\text{m}$	– $< \pm 25 \mu\text{m}$	– $< \pm 25 \mu\text{m}$
Vision System	– 5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.	– 5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.	– 5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.	– 5.1MP, 7 mm x 11 mm F.O.V.
Upstream Interface	– SMEMA	– SMEMA	– SMEMA	– SMEMA
Downstream Interface	– SMEMA	– SMEMA	– SMEMA/EtherCAT	– SMEMA
Workpiece Carrier Handling	– Manual	– Automatic	– Automatic	– Automatic
Workpiece Carrier Cleaning	– Manual	– Automatic	– Automatic	– Automatic
Output Finished Parts	– Manual / Semi-Automatic	– JEDEC Feeder	– Customized Shuttle Feeder	– Customized Tray Feeder

PSG は、エレクトロニクス製造分野において、お客様のバリューチェーン全体にわたる多彩な工程をご提供します

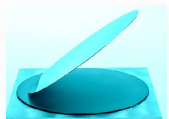
IC フロントエンド

IC パッケージング

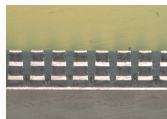
PCB 製造

デバイス製造

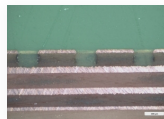
SMT 組立



SiCウェー
ハ分割



ICパッケ
ージ穴あ
け



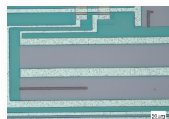
プリン
ト基板
穴あけ



回路トリ
ミング



PCB
分割処理

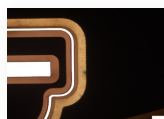


ウェーハ
トリミン
グ

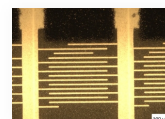


開発中

ウェー
ハダイ
シング



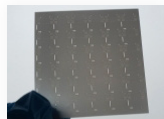
フレック
ス基板カ
ット



ChipR ト
リミング



レーザ
ー融合



セラミッ
ク基板の
切断・穴
あけ



DCB/AMB
のスクライ
ピング・ド
リリング

企業概要

ドイツ発のレーザー機器メーカー：自動化・検査・ブローピング分野に特化。

実績ある研究開発力：ラボから大量生産まで対応するスケラブルなソリューション。

一流企業との取引実績：世界的メガトレンドに沿った多様な市場にサービスを提供。

グローバルサポート：アジアと北米の拠点が24時間365日サポートを実現。



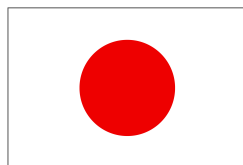
主要データ

- 世界中で 2900 台以上のシステム導入実績
- 本社所在地：ドイツ・ミュンヘン
- 従業員数：150 名

お問い合わせ

グローバルサポート：アジアと北米の拠点が週 7 日 X 24 時間サポートを実現

日本正規代理店：ワールドリンク合同会社
大阪府池田市旭丘 1-4-7
TEL：072-736-9959
FAX：072-736-9965
info@worldlink-jp.com
www.worldlink-jp.com



Photonics Systems GmbH

Pionierstrasse 6
82152 Krailling

www.photonics-systems-group.com

Laser depaneling of populated PCBs

実装済み基板のレーザー分割技術

Photonics Systems Group は、電子・半導体分野における最先端の高品質ソリューションを提供する業界のリーディングカンパニーです。